

# 國立交通大學

材料科學與工程學系研究所

碩士論文

三維積體電路封裝中錫2.5銀微凸塊的冶金反應之研究  
Study of Metallurgical reaction in Sn2.5Ag microbumps for  
3D IC packaging

研究生：楊若薇

指導教授：陳智博士

中華民國九十九年八月